



NEWS RELEASE

報道資料

2009年11月20日

(日本時間)

アプライド マテリアルズ、米セミツールを買収へ

この連携によりアプライドは急成長中のモバイル機器向け
最先端半導体パッケージング用装置のトップメーカーに

メモリー分野で進む Cu 配線化でもビジネスチャンスを拡大

アプライド マテリアルズ (Applied Materials, Inc., Nasdaq : AMAT、本社 : 米国カリフォルニア州サンタクララ、会長兼 CEO マイケル・スプリンター) と米セミツール (Semitool, Inc.) は 11 月 17 日 (現地時間)、アプライドがセミツールの発行済株式を 1 株あたり 11 ドルの現金による株式公開買付を実施することで正式合意したと発表しました。

アプライド マテリアルズはこの買収により、先進的なパッケージングとメモリーの Cu 配線化という 2 つの急成長分野をリードする装置メーカーとなります。その結果、アプライド マテリアルズはより広範な製品を提供できるようになり、半導体パッケージング分野における新規顧客獲得への道が開けます。

アプライド マテリアルズの会長兼 CEO マイケル・スプリンターは、次のように話しています。「スマートフォン、ノートパソコン、MP3 プレーヤー、携帯ゲーム機、電子ブックといった各種モバイル機器への需要が全世界で高まっていることが、半導体業界の業績回復を支えています。当社は今回発表した買収を通じて、世界トップクラスの半導体メーカーがより小型で強力なデバイスを製造することを支援します」

アプライド マテリアルズのシニアバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャー (シリコンシステムズグループ)、ランディア・タッカーは次のように述べています。「アプライド マテリアルズとセミツールは、大手半導体メーカーに向けた装置ソリューションの開発で協業してきた確かな実績を持っています。セミツールの社員と製品がアプライド マテリアルズに加わることで、業界における IC チップの小型化、高速化、低電力化をさらに促進できると考えています」

セミツールのレイ・トンプソン会長は次のように話しています。「セミツールがアプライド マテリアルズの一員となることで、当社が開発した技術の採用がグローバルに進むでしょう。今回の合意は社員の将来を力強く支え、株主の皆様にも価値をもたらすものです」

セミツールは米モンタナ州カリスペルに本社を置く電解めっき装置とウェーハ表面処理装置の大手サプライヤーで、その製品は世界中の半導体パッケージメーカーおよび半導体メーカーに採用されています。

両社の取締役会が承認した契約条件に従い、アプライド マテリアルズはセミツールの完全希薄化後時価総額に基づき、総額約 3 億 6,400 万ドルを支払います。買収はセミツールの全発行済株式を対象とした株式公開買付で実施されますが、セミツールの発行済株式総数（完全希薄化後ベース）の少なくとも 66 2/3%に達すること、および規制当局の承認その他慣習的な締結条件を満たすことが前提となります。セミツールの発行済普通株式の約 32%を保有するセミツールの取締役と役員は、すでに公開買付への応募に合意しています。アプライド マテリアルズは速やかに株式公開買付を開始したい考えで、買付け期間は 2009 年末までの予定です。終了後、アプライド マテリアルズは未取得のセミツール株式を公開買付の価格と同額で買い取る第 2 回目の買収を行います。セミツールは買収後、アプライド マテリアルズのシリコンシステムズグループの 1 ビジネスユニットとして運営される予定です。

セーフハーバー条項に基づく注意事項

本プレスリリースには、アプライド マテリアルズが予定しているセミツールの買収およびその取引から予想期待される利点（テクノロジーリーダーシップ、製品機能の向上、成長機会の拡大など）に関する将来の見通しが述べられています。将来見通しを記述した文章には、「期待する」「確信する」「するかもしれない」「し得る」「すべき」「する予定」「予測する」ないしこれに類した表現や、こうした記述の前提をなす仮定が含まれる場合があります。こうした記述は既知または未知のリスクや不確定要素に左右されるため、実際の結果はこうした記述が明示ないし暗示する帰結と大きく異なる場合があります。このようなリスクや不確定要素としては、①株式公開買付への応募がセミツール普通株の 66 2/3%に達しない、ハート・スコット・ロディノ反トラスト強化法やドイツ反トラスト法をクリアできない、その他の締結条件が満たされないなどの理由で買収が適時に成立せず、あるいは不調に終わるリスク、②買収した事業の統合の成否と業績、③未知、過小評価、ないし未開示のコミットメントや負債の存在、④内部統制の有効性、⑤ナノマニュファクチャリング・テクノロジー製品への需要水準（グローバルな経済・業界動向の不確実性、不況の続く期間と深刻度、事業支出や個人消費、エレクトロニクス製品や半導体への需要、顧客

企業の工場稼働率と生産設備ニーズなど多くの要因の影響を受ける)、⑥当社が(i)買収から期待されるシナジー効果を実現する能力、(ii)買収したテクノロジーを適正に事業化する能力、(iii)広範な製品を開発・提供・サポートして市場を拡大し、新規市場を開拓する能力、(iv)主力となる社員を引き付け、意欲を高め、引き留める能力、(v)主要テクノロジーに関する知的財産権を取得ならびに保護する能力、⑦その他、当社が証券取引委員会 (SEC) に提出する書類に記載しているリスクなどがあります。将来の見通しに関する記述はすべて本リリースの発表時点における経営陣の推定、予測、仮定に基づくものです。アプライド マテリアルズは将来の見通しに関する記述を更新する義務を負っておりません。

セミツールについて

セミツールは、半導体デバイスの製造に用いられる高性能なマルチチャンバ型枚葉式およびバッチ式のウェット表面処理装置の設計、製造、保守を行う企業です。主要製品は、銅、金、はんだ、その他金属のめっきに用いる電解成膜装置、シリコンウェーハの洗浄/ストリッピング/エッチング用の表面処理装置、ウェーハ搬送コンテナ洗浄装置などがあります。同社の製品は、ウェーハレベルパッケージングを含む半導体製造の前工程・後工程に用いられます。

セミツールは本社が米モンタナ州カリスペルにあり、米国、ヨーロッパ、アジアに営業とサポートセンターを設けています。同社の株式は Nasdaq に上場されています (銘柄コード SMTL)。詳細についてはホームページ (www.semitool.com) をご覧ください。

追加情報とその入手先

本発表は情報提供のみを目的としたもので、セミツール株式の買付提案あるいは売却の勧誘を意図したものではありません。セミツール株主の皆様には、本公開買付に関連した文書が入手可能になり次第これをお読みいただくよう強くお勧めします。そのような文書には、セミツール株主の皆様が公開買付応募について判断を下す前に考慮すべき重要情報が含まれているからです。本公開買付の開始時、アプライド マテリアルズと買収担当会社は米証券取引委員会 (SEC) に公開買付資料を、セミツールは本公開買付に関する意見表明書 (Solicitation/Recommendation Statement) を提出します。公開買付資料 (公開買付届出書、関連する譲渡書、その他買付書類を含む) と意見表明書には重要な情報が記載されていますので、公開買付について判断される前に必ずこれを熟読してください。公開買付届出書、関連する譲渡書、その他買付書類、および意見表明書は、セミツール株式所有者の皆様全員に無償で提供されます。公開買付資料と意見表明書は、SEC のウェブサイト www.sec.gov から無償で入手可能となります。また、本公開買付の情報管理代理人

(Innisfree M&A Incorporated, 501 Madison Avenue, 20th Floor, New York, New York 10022) まで書面でお申し込みいただくか、あるいは米国内の株主の方はフリーダイヤル(877) 687-1875、銀行およびブローカーの皆様はコレクトコール(212) 750-5833 へお電話でお申し込みいただければ上記文書を無償で入手できるほか、www.appliedmaterials.com と www.semitool.com から同様にお申し込みいただけます。

セミツールとアプライド マテリアルズは、公開買付届出書、関連する譲渡書、その他買付書類、および意見表明書のほか、年次報告書ならびに特別報告書その他の情報を SEC に提出しています。アプライド マテリアルズとセミツールが SEC に提出しているこうした報告書やその他の情報は、SEC の一般閲覧室 (100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549) で閲覧ならびにコピーが可能です。一般閲覧室に関する詳細情報については、SEC (1-800-SEC-0330) にお問い合わせください。アプライド マテリアルズとセミツールが SEC に提出している文書は、民間文献検索サービスおよび SEC のウェブサイト (<http://www.sec.gov>) から入手可能です。

アプライド マテリアルズは、半導体チップ、フラットパネル、太陽電池、フレキシブルエレクトロニクス、省エネガラスの製造におけるイノベーターな装置、サービスおよびソフトウェア製品を幅広く提供する Nanomanufacturing Technology™ ソリューションのグローバルリーダーです。アプライド マテリアルズは、人々のライフスタイルを向上させるナノマニュファクチャリングテクノロジーを提供します。

詳しい情報はホームページ : <http://www.appliedmaterials.com> でもご覧いただけます。

このリリースは 11 月 17 日米国においてアプライド マテリアルズが行った英文プレスリリースをアプライド マテリアルズ ジャパン株式会社が翻訳の上、発表するものです。

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:渡辺徹)は 1979 年 10 月に設立。大阪支店ほか 12 のサービスセンターを置き、日本の顧客へのサポート体制を整えています。

このリリースに関する詳しいお問い合わせは下記へ
投資家関係:

Applied Materials, Inc.
インベスターリレーションズ: 矢野 悦子 (Tel: +1-408-986-2646)
etsuko_joslen@amat.com

メディア関係:

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社
社長室: 大橋 百合 (Tel: 03-6812-6801)
ホームページ: <http://www.appliedmaterials.com>
